



size: 109x158 mm

- EN Thermal compound (grease) for heatsinks**
Helps the heat dissipation from a CPU, chipset or processor to a heatsink
Excellent thermal impedance
Perfect stability - will not separate, run, migrate, or bleed
Non capacitive or electrically conductive
- DE Wärmeleitpaste für Kühlkörper**
Unterstützt die Wärmeableitung von der CPU oder dem Chipsatz zum Kühlkörper
Läuft und tropft nicht
Nicht kapazitiv oder elektrisch leitfähig
- NL Koelpasta voor gebruik i.c.m. PC koellichamen**
Helpt om de warmte van een CPU, chipset of processor beter te geleiden naar een koellichaam
Uitstekende thermische geleiding
Uiterst stabiel- zal niet schiften, uitlopen of wegvloeien
Niet elektrisch geleidend
- RU Термопаста для теплоотводов (радиаторов)**
Помогает отводить тепло от процессоров, чипсетов к радиатору
Отличная теплопроводность
Прекрасная стабильность - не рассыпается, не вытекает
Электрически непроводящая
- UA Термопаста для радіаторів**
Допомагає відводити тепло від процесорів, чипсетів до радіатора
Відмінна теплопровідність
Прекрасна стабільність - не розсипається, не випливає
Без електропровідності
- PL Pasta termoprzewodząca przeznaczona do scalania z radiatorami**
Ułatwia odprowadzanie ciepła z procesora, chipsetu i procesora do radiatora
Doskonała impedancja termiczna
Zapewnia stabilność, doskonale scala, nie rozwarstwia się, nie utlenia.
Nie przewodzi prądu elektrycznego
- FR Graisse pour radiateur des microprocesseurs ou composants**
Facilite et optimise la dissipation de chaleur
Grande stabilité thermique
- ES Compuesto térmico (grasa) de los disipadores de calor**
Ayuda a la disipación de calor de la CPU, chipset o procesador con un disipador de calor
Excelente impedancia térmica
Estabilidad perfecta - no se separará, correr, migrar, o sangrar
No capacitiva o eléctricamente conductora

SPECIFICATIONS

Color: grey
Thermal conductivity:
> 4.5 W / mK
Thermal impedance < 0.205 °C
-in2 / W
Density: > 2.5
Evaporation: < 0.001 %
Volatility: < 0.005 %
The dielectric constant: > 5.1
Dissipation factor: < 0.005
Viscosity: 76 CPS
Thixotropic index: 310 °C ± 10 °C
Operating temperature:
- 50 °C - 240 °C
Composites: 50 % silicone
compounds
Compounds: 30 % of carbon
The compounds of metal oxides:
20 %
Weight: 3 g

proud to be a product of



www.gembird.eu

Gembird Europe BV

Wittevrouwen 56, 1358CD Almere, The Netherlands



All brands and logos are registered trademarks of their respective owners.



P/N: TG-G3.0-01



8 716309 083133

MADE IN CHINA